

BZ17-146 Cr-Cu ヒートシンク材の加工パートナー

提案提出期限

- 2017年10月31日

依頼企業の概要

- JFE 商事エレクトロニクス株式会社**
- <http://www.jfe-shoji-ele.co.jp/>
- 半導体および同周辺機器の販売・商品企画等
- 電子部品の実装・組立・検査等の装置および周辺機器等の販売・据付・保守等
- JFE 商事エレクトロニクス株式会社は、JFE グループにおける唯一のエレクトロニクス商社として、時代の先を見据え、技術サポート力とシステム提案力を備えたお客様のパートナーとして、半導体デバイスから各種エレクトロニクス機器等、特徴ある豊富なプロダクトの取扱いは勿論、これらを活用したソリューション&サポートの提供を続けてまいります。

提案者にとっての機会（協業形態）

中小企業・大学との想定される協業の形態を下記から選択ください（複数選択可）

	部材供給
<input type="radio"/>	受託加工
	技術ライセンス
<input type="radio"/>	受託開発
	その他（ ）

求める技術とその背景

- 弊社では、独自技術である高熱伝導・低熱膨張のCr-Cu複合材（主にヒートシンク・スプレッダー用途）を使った電子部品・デバイス市場の開拓を目指しております（競合材=Mo-Cu、W-Cu）。
- 其の際にCr-Cuヒートシンク材の加工の切削加工、研磨、ポリッシュ加工が可能なパートナーを求めています。

想定している用途

- 電子部品向けヒートシンク
- パワー・LED半導体用基盤

想定されるビジネス規模

- 開始当初は試作などの小ボリュームからスタートする予定です。
- スペックインが完了次第、量産規模 50,000 個 / 月程度のボリュームを見込んでおります。

開発スケジュール

- 素材自体の開発は完了しております。
- 2017年 スペックイン
- 2018年 量産開始予定

現時点で求める技術の完成度

- 電子部品向けヒートシンクの加工実績をお持ちであることが望ましいです。
- 同様にパワー・LED 基盤向けに加工実績をお持ちである企業様を希望します。

対象とするアプローチ例（下記に限らない）

- Mo-Cu、W-Cu の代替え材料の提案によるコストダウン。
- 顧客スペックインを行う際に、顧客要望に応じた精密切削、研磨技術を用いたサンプルを作成し、信頼性評価を実施。スペックインを行う。

BIZ SAITAMA の概要、提案方法はこちらの URL をご覧ください

http://biz-saitama.jp/exhibition_entry.html

【事務局】

- BIZ SAITAMA 実行委員会事務局：さいたま市産業創造財団
<http://www.sozo-saitama.or.jp/>
- 商談会に関するサポート：株式会社ナインシグマ・ジャパン
<http://www.ninesigma.co.jp/>

【問い合わせ窓口】

- メール：biz-sai9@sozo-saitama.or.jp
- 電話：03-3219-2006（ナインシグマ・ジャパン：BIZ SAITAMA 担当宛）